

公司代码：688439

公司简称：振华风光

**贵州振华风光半导体股份有限公司**  
**2025年年度报告摘要**

## 第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 <http://www.sse.com.cn> 网站仔细阅读年度报告全文。

### 2、 重大风险提示

公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

### 7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，拟以实施2025年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本200,000,000股，合计派发现金红利人民币34,000,000.00元（含税），占公司2025年度合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为20.00%。公司本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。

### 母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

### 8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

#### 1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	振华风光	688439	无

#### 1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

#### 1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）
姓名	张博学
联系地址	贵州省贵阳市高新区高纳路819号
电话	0851-86300002
传真	0851-86303492
电子信箱	irm@semifg.com

## 2、报告期公司主要业务简介

### 2.1 主要业务、主要产品或服务情况

报告期内，公司坚守“以客户为中心”的发展理念，积极应对变局、持续加大研发投入，新研、迭代一百余款产品，并积极布局前沿技术领域、大力推进科技成果转化，深度挖掘市场增量、加速新品推广；全面提升集成电路设计研发、供应链保障、生产组织、封装测试、应用验证、质量管控等综合能力，构建完整、高效的产业生态体系；深度挖掘市场增量，积极应对各种风险挑战，努力推动公司高质量可持续发展。

#### 1.主要业务情况

公司聚焦高可靠集成电路设计、封装、测试及销售，为客户打造电机控制、信号调理、射频微波等方向的信号链全域解决方案。信号链产品矩阵主要包括放大器、专用转换器、接口驱动、电源管理器、RISC-V 架构 MCU、射频微波芯片及抗辐照加固等产品。报告期内，公司持续加大主营产品研发投入，各产品线和谱系不断拓展升级，形成 400 余款产品，满足宽温区、长寿命、耐腐蚀、抗冲击等高可靠应用要求。公司承担了多项国家重大项目，放大器领域战略高地持续夯实，抗辐照领域实现首次突围。

#### 2.主要产品情况

第一，公司围绕以放大器、接口驱动、电源管理器、专用转换器、RISC-V 架构 MCU、射频微波芯片等六类产品为“点”，实现各细分领域技术突破；第二，以三大微系统为“面”，重点发展射频微波、电机控制、信号调理系统，推动产品从单一芯片向系统级解决方案升级；第三，以抗

辐照核心技术为“线”，贯穿全产品谱系，巩固高可靠产品技术壁垒，持续拓展应用场景。

#### （1）放大器

2025年，公司在放大器方向实现了核心技术的迭代突破和高性能产品矩阵的丰富完善。技术上突破了极点编程技术、低温漂高精度自偏置放大器输入级架构设计技术、适应高温极限电流的高可靠放大器设计技术、低失真高动态响应设计技术等关键技术。同时围绕新兴市场需求，攻关突破了高压轨到轨增强技术的核心难点，提升了宽动态范围、低输入偏置等关键指标，重点开发了高性能可编程放大器、高速低失真放大器为代表的新产品；在精密运算放大器领域，关键指标如失调电压和噪声电压密度达到国内领先水平。

#### （2）专用转换器

2025年，公司在已研制的专用转换器产品基础上开展迭代升级，成功突破自适应滤波技术、霍尔自校准技术、Sigma-Delta ADC 输出优化技术及专用转换器抗辐照技术等多项关键核心技术，完成多款产品系列化拓展。深耕磁编码感知领域，构建起从磁敏元件、信号处理到算法校准的完整自研技术体系，通过优化磁场拓扑结构、自适应误差补偿、多维度校准及宽温域漂移补偿等关键技术，实现磁编码器产品测量精度与响应转速大幅提升。产品具备优异的抗振动、抗油污、抗粉尘及强抗干扰能力，环境适应性显著增强，在多场景下替代部分传统光学编码器，有效解决伺服系统在高精度、高转速、强扰动工况下低速平稳性不足、高速测速失真、动态跟随误差大等问题，保障伺服系统运行稳定可靠、定位精准，有力支撑工业机器人、数控机床、伺服驱动等高端装备控制系统性能升级。

#### （3）接口驱动

2025年，公司在巩固接口、驱动器等核心产品优势基础上，聚焦性能升级与场景拓展，通过突破功率管栅极钳位保护、高传输速率信号收发、智能栅驱控制及电流斩波驱动电路等关键技术，成功研发多款创新产品并实现技术成果转化。其中，基于栅极钳位保护技术的高可靠栅极驱动器，有效解决功率器件因反电动势与开关脉冲导致的栅极击穿难题，具备-3V以上VS负偏压能力，显著提升系统可靠性；基于高传输速率收发技术的高性能接口驱动电路，实现10Mbps传输速率，满足高速通信场景需求；依托智能栅驱控制与电流斩波技术，推出的智能栅极驱动产品突破传统驱动模式，通过驱动电流5级可调、时序精准控制及动态电流调节等功能，可灵活适配工业控制、新能源汽车、智能电网等多领域复杂应用场景。

#### （4）系统集成封装电路

2025年，公司紧紧围绕用户装备朝着小型化、集成化的发展趋势，紧扣公司“信号调理、电机控制、射频微波”三大核心系统方向，与多家用户开展深度调研，分别在计算核心系统、模拟采集前端、多通道信号处理等方面挖掘到集成需求，成功研发了集信号采集、数据转换、数据处理的高集成系统集成产品，解决了用户空间受限、信号传输延时高等应用瓶颈。在微系统集成电路技术上，拉通整合大规模高速数字电路信号完整性、电源完整性、热仿真、结构仿真等关键技术，搭建全流程多物理场协同仿真体系。

#### （5）电源管理

2025年，公司在已研制的电压基准、低压线性稳压器、脉宽调制器等3个门类电源管理产品的基础上进行关键指标升级、持续攻坚关键模拟电源技术，攻克了高可靠性高精度封装级数字校准设计技术、低温漂低功耗高阶温度亚阈值曲率补偿设计技术、输出级扩流设计技术、大电流动态补偿设计及稳定性提升设计技术、全温区低漂移过流保护设计技术、自适应零点补偿技术、前馈补偿噪声抑制设计技术、高可靠性高压高功率半桥驱动设计等关键技术。

基于以上关键技术研制的新产品，线性稳压器实现10Hz~100kHz宽频段的噪声低至30μV、安培级大电流输出，电压基准电路温度漂移小于3ppm/°C，脉宽调制器转换效率达到90%以上。应用于飞行导航模块、航电通信模块、动力控制模块、高压通讯电源、工业电源、服务器电源等

供电电路中，解决了整机系统的效率、噪声、温度稳定性等问题，提高了系统可靠性。

#### (6) 射频微波芯片

①首款 18GHz 微波频率合成器芯片下线，集成 FMCW 扫频功能，实测关键指标达到预期，积分抖动低至 40fs，实现 18GHz 的频率覆盖，技术指标对比国内领先，各项功能符合预期。

②超宽带捷变频射频收发芯片开发顺利推进，集成两发两收和快速跳频功能，射频工作范围可达 6GHz，最大信号带宽可达 400MHz，单芯片实现从射频到数字信号的转换，同时内置校准算法保证射频各项指标达到国外竞品相当的性能，可满足所有常规无线通信制式的应用场景。在此基础上，为新一代超宽带捷变频射频收发芯片的频率范围拓展至 18GHz、信号带宽拓宽至 800MHz 和 1GHz 提供研制基础，以满足未来无线通信系统小型化、大带宽、高集成、高性能的发展需求。

#### (7) RISC-V 架构 MCU

2025 年，公司坚持以满足用户应用场景为导向，着力布局市场技术支持团队，积极搭建应用生态，牵引用户在特定场景中优先选用。通过积极沟通，在某用户重点的电机控制场景中已被作为首选。该产品为公司新推出的超低功耗 MCU，基于 32 位 RISC-V RV32EMC 内核、最高 48MHz 工作频率，内置指令缓存与增强中断控制器，实现高效响应与低延迟处理，芯片集成 16 位通道的 12 位 ADC、12 位 DAC、运算放大器及电压比较器等模拟资源，支持多模态信号采集与高精度控制；具备宽电压输入与超低功耗设计，可满足电池供应场景的长续航需求；内置 CAN、URAT、SPI、RTC 等通讯资源及 ATIM、RTC 等定时器资源。凭借其高集成模拟、超低功耗特性和高适应性总线架构，已被用户列为机电管理计算机远程接口单元的计算芯片。

#### (8) 抗辐照产品

公司在抗辐照技术领域取得重大突破，自主研发的双极工艺技术显著提升抗单粒子能力，达到行业严苛标准。通过技术创新，成功构建单粒子效应实时监控系統，实现瞬态波形智能捕获、电流动态监测及单粒子门锁防护等全流程自动化管理，为产品可靠性提供坚实保障。经专业机构严格验证，多款核心产品具备卓越的抗辐照性能，满足高可靠应用场景需求。部分产品已通过宇航级标准认证并完成应用验证，成功为高可靠领域多家客户批量供货，多款产品入选权威目录并配套商业航天项目，同步推进在轨搭载试验验证，实现技术成果与市场应用的双重突破。

## 2.2 主要经营模式

### 1. 研发模式

公司坚持“市场与技术”双轮驱动引领的研发模式，构建了需求牵引与技术引领协同的研发体系。一是市场需求牵引模式：深入客户前端挖掘需求，通过“客户-方案-交付”三角营销及 FAE/AE 团队协同，将用户需求定制植入产品研发，创造高质优品。二是技术发展引领模式：依托“多中心研发网络”协同研发平台，聚焦信号链、电源管理、RISC-V 架构 MCU 及射频微波芯片等方向开展前沿技术研究；持续推进与高校的“产学研”合作，夯实基础研究，加快成果转化；同时，公司积极与供应商构建柔性绑定模式，通过优化供应链结构、建立多元化供应渠道及强化风险共担机制，全面提升供应链的安全可控能力。

### 2. 生产模式

公司产品的生产流程主要包括晶圆制造、封装测试、筛选等环节，其中晶圆制造过程委外加工，封装测试筛选等过程均由公司自主完成。公司建立了严格的外协准入与考评机制，以保障产品质量稳定、供货及时高效，支撑各生产环节协同运作。根据在手订单情况或者客户需求预测安排生产计划，生产部门全流程使用 MESEAP 系统进行生产管理。根据当年企业经营目标要求，科学制定生产计划，精准控制进度。生产过程中组织收集生产产品的质量信息、成本信息、产能信息等方面进行生产大数据分析，不断总结，进而实现快速交付，提高合同履约率，满足客户需求。

### 3. 销售模式

公司产品销售采用直营销售模式，销售产品可广泛应用于宽温区、长寿命、耐腐蚀、抗冲击等高可靠应用场景。在全国七大片区设立了十五个销售网，近百人的销售和技术团队常年驻在销售网点，深入了解客户需求和实际情况，与开发团队共同协作，现场提供全面的技术支持和维护服务，以保障服务质量和效率。

## 2.3 所处行业情况

### (1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

#### (1) 行业发展阶段和基本特点

《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》明确提出“强化集成电路基础支撑能力”，2026年全国两会进一步明确，集成电路作为信息产业的基石，位列六大新兴支柱产业首位，明确要求全链条推动重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。公司所属高可靠集成电路行业，是集成电路产业的核心战略细分赛道，产品在各类电子系统中承担信号转换、电源管理等基础支撑功能，是装备信息化、智能化、数字化的核心基石，直接服务于国家安全、新能源等国家战略性领域，是推动新质生产力发展、构建安全可控现代化产业体系的关键核心载体。

集成电路作为关系国家安全和国民经济命脉的基础性、先导性、战略性产业，当前正处于全球产业格局深度调整、创新模式加速转型的关键窗口期。随着全球产业链供应链重构、国家科技安全与产业安全自主要求持续升级，叠加新一代信息技术、新能源、商业航天、低空经济、新型储能、工业母机、智能机器人等战略性新兴产业与未来产业的深度融合，高端高可靠芯片的刚性需求持续放量，行业发展空间持续拓宽。

2025年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局的关键衔接之年，国家层面持续出台集成电路产业专项支持政策，聚焦关键核心技术攻关与产业链安全可控重点布局，行业发展的政策支撑力度与战略导向持续强化。2026年作为“十五五”规划实施开局之年，行业将进入国产替代从规模化突破向高端化、全链条化升级的关键阶段，政策支撑、需求扩容、技术迭代三大核心驱动逻辑将持续强化，行业整体发展形势稳中向好。根据国际权威研究机构 Omdia 发布的《半导体应用领域市场预测工具 (AMFT) - 中国地区 (4Q25)》报告，2025年中国半导体市场规模达 4163 亿美元，同比增长 21.63%；预计 2026 年市场规模将进一步增长至 5465 亿美元，同比增速达 31.26%，行业整体景气度持续回升，为公司所处的高可靠集成电路细分赛道营造了良好的产业发展环境。

#### (2) 主要技术门槛

作为支撑国家安全、航空等国家战略性高端领域的核心基础元器件，高可靠集成电路行业技术准入壁垒极高，与通用民用集成电路赛道存在本质差异，核心壁垒围绕极端场景可靠性、全链条技术协同与全生命周期保障能力构建。

行业产品需在极端温度、强辐射、强振动、高抗静电等严苛工况下长期稳定运行，需攻克抗辐射加固、抗位移加固、宽温域材料适配、缺陷密度 $\leq 0.1/\text{cm}^2$  的超低缺陷率制造等关键技术，完成符合国家相关标准要求的全生命周期可靠性验证。同时需突破大功率热管理、高集成度小型化等特种封装工艺与全场景抗干扰设计技术，建立 10-30 年长周期供应链保障体系，并通过严苛质量管理体系认证。

集成电路全链条涵盖设计、制造、封装、测试等核心环节，属典型资金、技术、人才密集型产业。高可靠产品具备多品种、小批量、定制化特征，要求企业兼具深厚技术积累、全流程工艺匹配能力与多专业协同研发体系，对团队综合能力要求极高。行业核心技术门槛，集中体现为跨学科协同创新能力与全链条自主可控技术体系的长期沉淀，构成新进入者难以逾越的竞争壁垒。

## (2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

当前正值国家战略性新兴产业格局深刻调整和创新范式转型的关键窗口期，随着全球产业链供应链重构与国家科技安全、产业安全自主化要求持续升级，国家安全建设从效率优先向安全为核心、效率与成本协同并重升级，叠加商业航天、低空经济、人工智能、新型储能等新兴产业及未来产业的快速发展，集成电路技术竞争焦点向超异构集成化（Chiplet/3D-IC）、全链路系统化及场景适配精准化（极端环境高可靠性、超低功耗设计）延伸，持续催生高端高可靠芯片需求放量，高可靠电子产业进入新一轮稳健增长周期。根据国际权威研究机构Omdia发布的最新数据，2025年全球半导体市场规模超过8300亿美元，连续第二年实现超20%的同比增长；据中国半导体行业协会集成电路设计分会发布的数据，2025年中国集成电路设计产业销售额同比增长29.4%，行业景气度持续提升。

公司经过五十余年的技术沉淀与产业深耕，目前已建成成熟的模拟、数模混合及系统集成设计平台，具备陶瓷、金属、塑料等多种形式的高可靠封装能力，模块类产品SMT生产能力，以及电性能测试、机械试验、环境试验、失效分析等完整的检测试验能力，形成了覆盖芯片设计、封装测试、验证应用的全链条产业能力。公司在信号链领域是国内高可靠放大器产品谱系覆盖面最全的厂家之一，是国内单片高可靠轴角转换器产品首款成功研制单位，在行业内占据重要地位。2025年，公司持续深化市场导向与技术创新相结合的发展战略，紧紧围绕关键核心技术攻关、前沿性原创技术开展研究，持续加大科研投入，前置市场需求分析与场景适配研发。公司促进营销模式创新，强化客户需求精准把握能力，实现上下游协同设计，持续完善高水平科研创新体系，激发多地多方向多模式创新活力，积极布局并突破RISC-V架构MCU、射频微波等新赛道核心技术，不断掌握更多关键核心技术和源头底层技术，力争抢占产业发展新制高点。

围绕核心方向持续迭代产品，不断突破抗辐照、耐高温、长寿命等特种半导体设计技术难点，持续夯实高可靠领域技术优势壁垒，拓展通用型及定制型单片集成电路、混合集成电路、模块及微系统产品谱系，可为用户提供电机控制、信号调理、射频微波等方向的信号链全域解决方案。当前，公司推出的高速高精度运算放大器、可编程隔离放大器、磁编码转换器、LVDT信号调理电路、隔离驱动器、高速模拟开关、高精电源、电机驱动模块、32位RISC-V架构MCU、系统集成电路、抗辐照器件等多个系列产品指标对比达到国内领先水平，在商业航天、低空经济等新兴高可靠场景实现应用突破，部分产品进入小卫星选用目录并形成订单。

公司在高可靠模拟IC领域更具差异化优势，目前已经通过IATF 16949、AS 9100D体系认证，但消费级半导体领域布局较少，国际巨头仍主导高端市场，公司正积极开展前瞻布局与技术储备，为后续切入消费级半导体赛道做好充分准备。与此同时，公司持续推进核心技术攻关，不断构筑自主技术壁垒，已形成覆盖多品类、多应用场景的产品矩阵，并凭借定制化服务与本地化供应能力深度绑定下游核心客户，在高可靠集成电路国产化加速推进的进程中持续巩固先发优势，核心竞争力稳步提升。

## (3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着工业技术持续升级与宽禁带半导体等新型材料规模化应用，集成电路产业以高集成度、高性能、低功耗为核心目标，形成设计工艺突破与先进封装创新双轨并行的发展路径，以SoC、高可靠异构集成为代表的技术逐步实现工程化落地。据行业研究分析，行业创新重心已从单一制程升级向“设计—工艺—封装”全链条协同创新转型，新型集成电路技术已逐步在高可靠场景实现应用，产品应用边界持续拓宽。

市场需求与产业政策方面，当前行业需求持续向信息化、智能化、小型化演进，高端装备现

代化升级始终离不开高可靠集成电路的核心支撑。根据工业和信息化部等发布的《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，商业航天、低空经济、人工智能等新兴产业的快速发展，持续拉动高可靠集成电路需求稳步增长，行业长期增长动能充足。

公司持续聚焦战略性新兴产业高可靠市场核心需求，加大研发投入，有效提升研发效能、缩短产品研发周期。公司依托磁编码器、RISC-V架构MCU、射频微波等核心芯片与多品类高可靠先进封装能力，持续拓展应用场景、丰富产品矩阵，以小型化、智能化、高集成化为目标完善产业生态，为用户提供模拟信号链全域解决方案，在新兴高可靠场景实现应用突破。

### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年		本年比上年 增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	5,606,480,478.67	5,440,274,279.47	5,482,189,235.33	3.06	5,360,467,694.95
归属于上市公司股东的净资产	5,030,471,511.29	4,890,713,236.21	4,925,550,711.98	2.86	4,728,955,491.23
营业收入	771,623,013.68	1,003,411,310.27	1,063,107,423.37	-23.10	1,297,124,405.47
利润总额	171,355,637.63	349,061,131.10	390,046,396.70	-50.91	709,919,061.40
归属于上市公司股东的净利润	170,040,775.08	287,700,244.98	322,537,720.75	-40.90	610,606,050.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,589,855.61	255,497,436.19	290,334,911.96	-41.45	587,176,645.42
经营活动产生的现金流量净额	552,367,853.26	256,583,931.16	256,583,931.16	不适用	32,355,025.14
加权平均净资产收益率(%)	3.43	5.99	6.69	减少2.56个百分点	13.71
基本每股收益(元/股)	0.8502	1.4385	1.6127	-40.90	3.0530
稀释每股收益(元/股)	0.8502	1.4385	1.6127	-40.90	3.0530
研发投入占营业收入的比例(%)	22.25	14.35	13.54	增加7.90个百分点	11.80

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	189,223,791.08	275,433,657.81	235,861,148.27	71,104,416.52
归属于上市公司股东的净利润	20,085,021.10	43,249,113.85	32,716,626.33	73,990,013.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,181,083.47	39,680,836.78	29,111,819.30	67,616,116.06
经营活动产生的现金流量净额	-58,893,214.37	225,165,442.42	-82,319,074.82	468,414,700.03

#### 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

经公司自查发现，公司于 2025 年 1 月收到客户 A 退货，由于客户退货事项存在不确定性，导致内部判断错误，使得上述退货未作为 2024 年度期后调整事项进行账务处理，该事项影响公司 2024 年度多计营业收入 5,969.61 万元，多计归属于母公司的净利润 3,483.75 万元，占公司 2024 年度营业收入和归母净利润分别为 5.62%、10.80%。

追溯调整 2024 年年度、2025 年第一季度、2025 年半年度、2025 年第三季度的财务报表和财务数据，上表中的 2025 年分季度主要财务数据，是本次追溯调整后的数据，与已披露季度定期报告数据有差异。

## 4、 股东情况

### 4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	15,270					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,403					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0					
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0					
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条	质押、标记或冻结情况	股东性质

				件股份 数量	股份 状态	数量	
中国振华电子集团有限公司	0	80,239,970	40.12	0	无	0	国有法人
深圳市正和兴电子有限公司	-5,556,800	33,754,734	16.88	0	无	0	境内非国有法人
中电金投控股有限公司	0	5,842,388	2.92	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,405,586	1,769,940	0.88	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	-870,460	1,281,266	0.64	0	无	0	其他
刘育辰	未知	990,000	0.50	0	无	0	境内自然人
吴希龙	未知	942,008	0.47	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	225,377	894,656	0.45	0	无	0	其他
吴漪	未知	832,343	0.42	0	无	0	境内自然人
广发证券股份有限公司—鹏华上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金	45,492	699,981	0.35	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 公司实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司，中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司同受中国电子实际控制； 2. 公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

**存托凭证持有人情况**

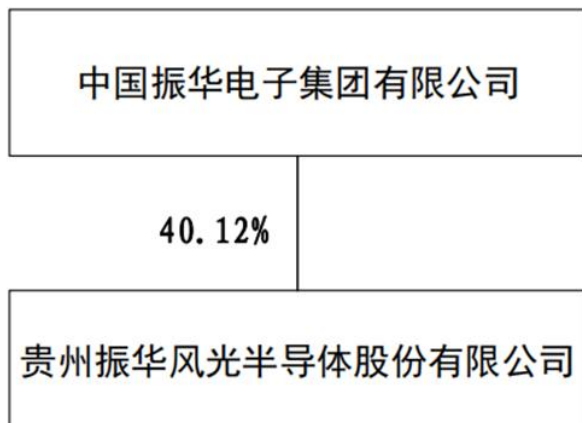
适用 不适用

**截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

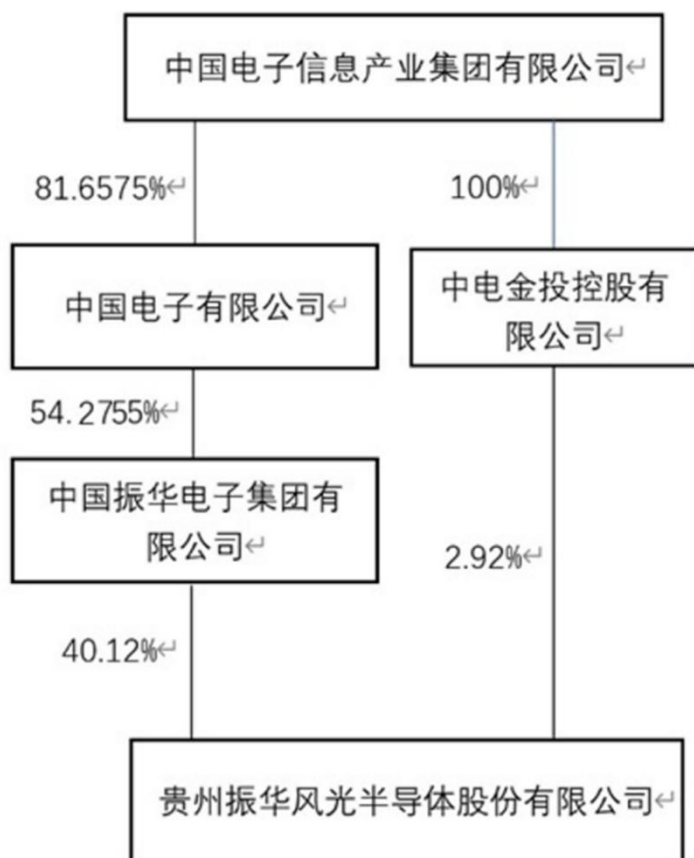
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

## 5、公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

请参见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用